

108-5296

Rev. D

Product Specification

(製品規格)

AMP MODU 2mm Pitch, Board-to-Board Connector

アンプ モジュ 2mm ピッチコネクター(基板対基板取付型)

Following first 9 pages are English version and last 7 pages are Japanese version. This top sheet is not part of the specification but explains both of English and Japanese versions are available.

このトップシートに続く最初の 9 ページは英語版で、その後の 7 ページは日本語版です。
このトップシートは、規格には含まれませんが、英語、日本語両方があることを説明しています。

Product Specification

108-5296

AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector

1. Scope :

1.1 Contents

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector consisting of receptacle assembly, vertical mount type, and 0.5 mm square post header as a mating counterpart.

The applicable product descriptions and part number are as shown in Fig. 1 :

Product Part No.	Descriptions
X-176135-X	Receptacle Assembly
X-176136-X	Receptacle Assembly
X-176384-X	Receptacle Assembly, 32-Position with Ear Type
X-176979-X	Receptacle Assembly, White Housing
X-176264-X	Post-Header, Vertical Mounting
X-176980-X	Post-Header, Vertical Mounting, White Housing
X-176837-X	Post-Header, Horizontal Mounting

Fig. 1

2. Applicable Documents :

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

					DR. <i>I. Enomoto</i> 26-MAR-90 I. ENOMOTO	SHEET 1 OF 9	 AMP Tyco Electronics AMP K. K.			
					CHK. <i>T. DOI</i> 26-MAR-90 I. ENOMOTO		LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D
D	ECN No. FJ00-1220-00	<i>X.L.</i>	<i>J.E.</i>	9.21.90	APP. <i>T. DOI</i> 26-MAR-90 T. DOI		NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector			
C	ECN No. FJ00-5336-96	I.E	<i>Y.Y.</i>	9.17'96						
B ₁	Revised Corrected	I.E	<i>M.S.</i>	1.12'91						
B	Revised RFA-1774	I.E	<i>T.D.</i>	3.26'90						
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE						

108-5296

NUMBER :

Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION :PRINT
DIST.

108-5296

NUMBER :

Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION :

2.1 AMP Specification :

- A. 109-5000 Test Specification, General Requirements for Test Methods
B. 501-5076 Test Report

2.2 Military Standard and Specification :

MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts

3. Requirements :

3.1 Design and Construction :

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified in the applicable product drawing.

3.2 Materials :

A. Contact

Receptacle Contact

Material : Copper Alloy

- Finish :
- a) 0.00076 mm min. thick gold-plated on contact area only over nickel underplate all over
 - b) 0.0002 mm min. thick gold-plated on contact area only over nickel underplate all over

Post Contact :

Material : Brass

- Finish :
- a) 0.00076 mm min. thick gold-plated on contact area only over nickel underplate all over
 - b) 0.0002 mm min. thick gold-plated on contact area only over nickel underplate all over

B. Housing :

Receptacle Housing, Post Support Housing

Material : Thermoplastic Molded Compound

Finish : UL 94 V-0

3.3 Ratings :

- A. Voltage Rating : 200 VAC
B. Current Rating : 1 A, per contact
C. Temperature Rating : - 40 °C to + 105 °C

SHEET	 Tyco Electronics AMP K. K.				
	2 OF 9	<table border="1"> <tr> <td>LOC J</td> <td>LOC A</td> <td>NO. 108-5296</td> <td>REV. D</td> </tr> </table>	LOC J	LOC A	NO. 108-5296
LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D		
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector					

NUMBER: 108-5296

NUMBER:

Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION:

3.4 Performance and Test Descriptions :

The product is designed meet to the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 2. All tests are performed at ambient temperature unless otherwise specified.

3.5 Test Requirements and Procedures Summary :

Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.1	Confirmation of Product	Product shall be conforming to the requirements of applicable product drawing.	Visually, dimensionally and functionally inspected per applicable inspection plan.
Electrical Performance			
3.5.2	Termination Resistance (Low level)	15 m Ω max. (Initial)	Subject mated contacts assembled in housing to closed circuit current of 50 mA max. at open circuit voltage of 50 mV max. Fig.4 AMP Spec. 109-5306
3.5.3	Dielectric Strength	Connector must withstand the test potential without presence of insulation breakdown nor flashover.	Measure by applying test potential of 650 VAC between the adjacent contacts, and between the contacts and ground in the unmated connectors for 1 minute. MIL-STD-202, Method 301
3.5.4	Insulation Resistance	1,000 M Ω min. (Initial) 1,000 M Ω min. (Final)	Measure by applying test potential between the adjacent contacts, and between the contacts and ground in the unmated connector. MIL-STD-202 , Method 302 Condition B

Fig. 2 (to be continued)

SHEET 3 OF 9	 Tyco Electronics AMP K. K.			REV. D
	LOC J	LOC A	NO. 108-5296	
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector				

NUMBER : 108-5296

Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION :

Para.	Test Items	Requirements	Procedures
Physical Performance			
3.5.5	Vibration Sinusoidal High Frequency	No electrical discontinuity greater than 1 microsecond (s) shall occur.	Subject mated connectors to 10-500-10 Hz traversed in 15 minutes with 98m/s^2 (10G) accelerated velocity; 3 hours each of 3 mutually perpendicular planes. MIL-STD-202, Method 204, Condition A
3.5.6	Physical Shock	No electrical discontinuity greater than 1 microsecond (s) shall occur.	Subject mated connectors to 98m/s^2 (50G) sawtooth shock pulses of 11 millisecond duration ; 3 shocks in each direction applied along the 3 mutually perpendicular planes total 18 shocks ; MIL-STD-202, Method 213, Condition A
3.5.7	Connector Mating Force	1.96N (200g)max. (initial) per contact	After applying 3 cycles of mating/unmating preconditioning, measure the force required to mate connector using locking latch by operating at 100 mm a minute, Record by using autograph. Calculate the value for a contact. AMP Spec. 109-5206
3.5.8	Connector Unmating Force	0.098N(10g)min. (initial) per contact	After applying 3 cycles of mating/unmating preconditioning, using autograph measure the force required to unmate connector without locking latch set in effect, by operating at 100 mm a minute. Calculate value for a contact.

Fig. 2 (to be continued)

SHEET 4 OF 9	tyco Electronics AMP			Tyco Electronics AMP K. K.	
	LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D	
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector					

NUMBER:
108-5296Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION:

Para.	Test Items	Requirements	Procedures						
3.5.9	Contact Mating Force	2.94N(300g)max. per contact. Fig.3 (1) gage pin.	Masure the force mating using gage (1) as indicated in Fig.5. AMP Spec. 109-5206						
3.5.10	Contact Unmating Force	0.098N(10g)min. per contact. Fig.3 (2) gage pin.	Masure the force unmating using gage (2) as indicated in Fig.5. AMP Spec. 109-5206						
3.5.11	Durability (Repeated Mate/Unmating)	No abnormalities shall be present. The requirements per Paras. 3.5.2, 3.5.9 & 3.5.10 shall be met.	Repeat mating/unmating of connector for the following cycles at a rate of 500- 600 cycles an hour. <table><tr><th>Contact Gold Plating Thickness</th><th>Cycles</th></tr><tr><td>0.76 μm minimum</td><td>100</td></tr><tr><td>0.2 μm minimum</td><td>50</td></tr></table>	Contact Gold Plating Thickness	Cycles	0.76 μm minimum	100	0.2 μm minimum	50
Contact Gold Plating Thickness	Cycles								
0.76 μm minimum	100								
0.2 μm minimum	50								
3.5.12	Solderability	Solderable area shall have a solder coverage of 95% minimum.	Subject contacts to melted 60 tin/40 lead solder tub at 230 ± 5 °C for 3 ± 0.5 seconds, after immersing into flux (Alpha-100, GX-5 or GX-7 for 5-10 seconds.) MIL-STD-202, Method 208						
Environmental Performance									
3.5.13	Resistance to Soldering Heat	No physical damage	Subject connector mounted on printed circuit boards to solder bath at 260 ± 5 °C for 10 ± 2 seconds MIL-STD-202, Method 210 Condition C						

Fig. 2 (to be continued)

SHEET 5 OF 9	tyco Electronics AMP			Tyco Electronics AMP K. K.	
	LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D	
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector					

NUMBER : 108-5296

Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION :

Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.14	Thermal Shock	No physical abnormalities shall be present. The requirement per Para. 3.5.2 shall be met.	Subject mated/unmated connectors to 5 cycles between -40°C and 105°C . MIL-STD-202, Method 107, Condition A
3.5.15	Humidity-Temperature Cycling	No physical abnormalities shall be present. The requirements per Paras. 3.5.2, 3.5.3 & 3.5.4 shall be met.	Subject mated connectors to 10 cycles of humidity-temperature changes between 25°C and 65°C at 95% R. H. MIL-STD-202, Method 106, (without low frequency vibration, and cold shock at -10°C .) Condition A
3.5.16	Salt Spray	The requirements per Para. 3.5.2 shall be met.	Subject mated/unmated connectors to 5% salt concentration for 48 hours ; MIL-STD-202, Method 101, Condition B
3.5.17	Sulfurous Acid Gas Exposure	The requirements per Para. 3.5.2 shall be met.	Subject mated connectors to sulfurous Acid gas test exposure under the following condition. Sulfurous Acid Gas : 10 ± 3 ppm, 90% min. RH, Room Temperature, Duration : 24 hours. Recondition for 1 hour in the room temperature before measurement. AMP Spec. 109-85

Fig. 2 (end)

SHEET	 Tyco Electronics AMP K. K.		
			
6 OF 9	LOC J	LOC A	NO. 108-5296
REV. D			
NAME			
AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector			

108-5296

NUMBER:

Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION:

4 Product Qualification and Requalification Tests

Test of Examination	Test Group (a)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Test Sequence (b)							
Examination of Product	1,9	1,6	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Termination Resistance, Dry Circuit	2,6		2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Dielectric Withstanding Voltage	4,8							
Insulation Resistance	3,7							
Vibration				3				
Physical Shock					3			
Mating Force			3,6					
Unmating Force			4,7					
Contact Engaging Force		2						
Contact Separating Force		3						
Durability			5					
Solderability		4						
Resistance to Soldering Heat		5						
Thermal Shock (per Product Spec)						3		
Humidity-Temperature Cycling	5							
Corrosion, Salt Spray							3	
Sulfurous Acid Gas Exposure								3

(a) Numbers indicate sequence in which tests are performed.

Fig. 3

SHEET	 Tyco Electronics AMP K. K.			
	AMP			
7 OF 9	LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector				

NUMBER:
108-5296Customer
ReleaseSECURITY
CLASSIFICATION:

5. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS

5.1 Test Conditions :

Unless otherwise specified, all the tests shall be performed under any combination of the following test conditions.

Temperature : 15 -35 °C

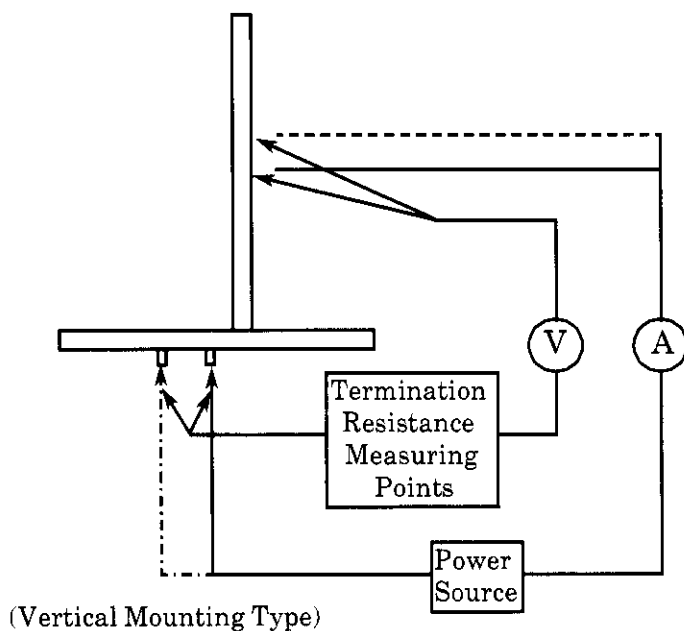
Relative Humidity : 45 - 75 %

Atmospheric Pressure : 650 - 800 mmHg

5.2 Test Specimens :

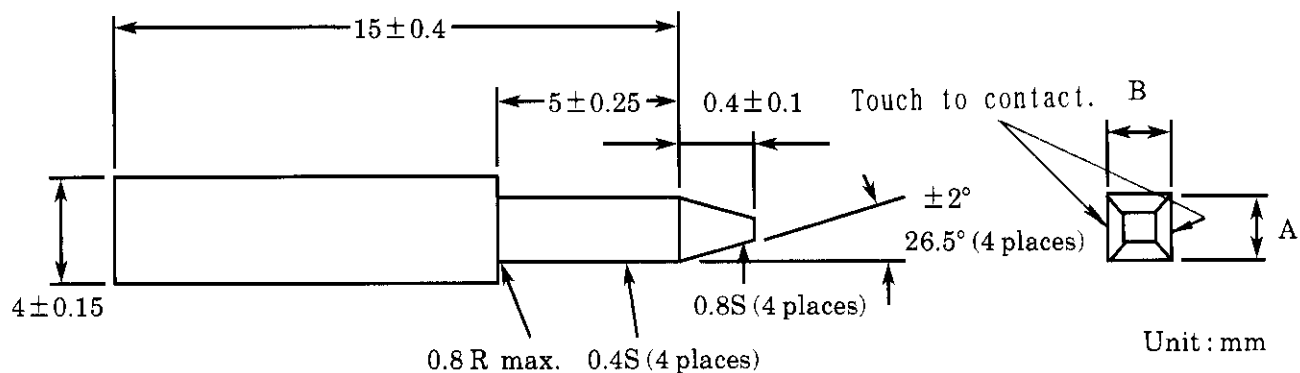
- (1) The test samples to be used for the tests shall be conforming to the requirements of the applicable product drawing (s).
- (2) Unless otherwise specified, no sample shall be reused for the tests.

SHEET	tyco Electronics Tyco Electronics AMP K. K. AMP			
	LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D
8 OF 9				
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector				



When the tests are performed, plating of the post contacts shall be corresponding to that of receptacle contact to be used for testing.

Fig. 4 Termination Resistance (Low Level) Measuring Points



Notes :

1. Material : Tool Steel, Hardness : RC 50-55
2. Before applying for measurement, remove lubricant oil from the surfaces of working area.

Gage	A	B
(1)	0.5 ± 0.005	$0.56 \begin{smallmatrix} +0 \\ -0.003 \end{smallmatrix}$
(2)	0.5 ± 0.005	$0.44 \begin{smallmatrix} +0.003 \\ -0 \end{smallmatrix}$

Fig. 5 Mating/unmating Force Measurement Gage

SHEET	tyco Electronics AMP				Tyco Electronics AMP K. K.	
	9 OF 9		LOC J	LOC A	NO. 108-5296	REV. D
NAME AMP MODU 2 mm Pitch, Board-to-Board Connector						

社 内 標 準
(技 術 標 準)

tyco
Electronics

AMP

タイコエレクトロニクスアンプ株式会社

適用事業所

全 社

管理基準：一般顧客用

108-5296

製 品 規 格

アンプモジュール 2 mm ピッチコネクタ

(基板対基板取付型)

1. 適用範囲

1.1 内 容

本規格はリセプタクルアッセンブリ垂直取付型と、これに嵌合する0.5 mm 角ポスト・ヘッダーで構成される基板対基板結線用アンプモジュール 2 mm ピッチコネクタの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。

適用製品名と型番は以下の通りである。

型 番	品 名	備 考
□-176135-□	リセプタクルアッセンブリ	
□-176136-□	リセプタクルアッセンブリ	
□-176384-□	リセプタクルアッセンブリ	32 極取付
□-176979-□	リセプタクルアッセンブリ	白色ハウジング
□-176264-□	ポスト・ヘッダー垂直取付型	
□-176980-□	ポスト・ヘッダー垂直取付型	白色ハウジング
□-176837-□	ポスト・ヘッダー水平取付型	
その他		

2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

						作成： I. ENOMOTO 15-DEC-88	分類： 製 品 規 格		
D	改訂	FJ00-1220-00	SK	SK	RE	7.21.00	検閲： T. DOI 15-DEC-88	コード： 108-5296	改訂 D
C	改訂	FJ00-5336-96	I.E	Y.Y	Y.Y	9.17'96			
B	改訂	RFA-1774	I.E	T.D	T.D	3.26'91			
A	改訂	RFA-1751	I.E	I.E	H.T	1.21'93	承認： T. DOI 15-DEC-88	名称： アンプモジュ 2 mm ピッチコネクター (基板対基板取付型)	
0	改訂	REA-1435	I.E	S.M	H.T	12.15'88			
年 月 日 制 定			7 頁 中 1 頁						

2.1 AMP 規格

- A. 109-5000 試験法の一般条件
- B. 501-5076 試験報告書

2.2 米軍標準書

MIL-STD-202 電子電気部品の試験方法

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材 料

A. コンタクト

リセプタクルコンタクト:

- 材 質 : 銅合金
- 表面処理 : a. 全面ニッケル下地、接触部金めっき0.00076 mm MIN 厚
- b. 全面ニッケル下地、接触部金めっき0.0002 mm MIN 厚

ポスト:

- 材 質 : 黄銅
- 表面処理 : a. 全面ニッケル下地、接触部金めっき0.00076 mm MIN 厚
- b. 全面ニッケル下地、接触部金めっき0.0002 mm MIN 厚

B.ハウジング

リセプタクルハウジング、ポストサポートハウジング:

- 材 質 : 熱可塑性樹脂
- 難 燃 性 : UL94 V-0

3.3 定 格

- A. 電圧定格 200 VAC
- B. 電流定格 1 A, 1 コンタクト当り
- C. 温度定格 -40°C~105°C

3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig. 2 に規定された電氣的、機械的、及び耐環境的特性を有するよう設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

項目	試験項目	性能値	試験方法
3.5.1	製品の確認検査	製品図面の必要条件を合致していること。	該当する品質検査計画書に基づいて目視、寸法、及び機能検査を行なうこと。
機 械 的 性 能			
3.5.2	総合抵抗 (ローレベル)	15 mΩ 以下 (初期値)	ハウジングに組込まれ嵌合したコンタクトに 開路電圧 50 mV, 開路電流 50 mA の試験電流を通電する。 Fig. 4 参照。 AMP 規格 109-5306
3.5.3	耐電圧	絶縁破壊やフラッシュオーバーのないこと。	嵌合なしのコネクタ・アセンブリの隣接コンタクト間で測定。650 VAC の試験電圧 (1 分間保持) に耐えること。 MIL-STD-202, 試験法 301
3.5.4	絶縁抵抗	1000 MΩ 以上 (初期値) 1000 MΩ 以上 (試験後)	コネクタ嵌合なし 隣接コンタクト間で測定。 MIL-STD-202, 試験法 302 条件 B
3.5.5	振動	振動中 1 μsec をこえる不連続導通を生じないこと。	嵌合したコネクタを 15 分間に 10Hz~500Hz と掃引変化する 98m/s ² (10G) の加速度を持つ振動を直交する三方向軸に各 3 時間づつ加えること。 MIL-STD-202 試験法 204, 条件 A
3.5.6	衝撃	衝撃により 1 μsec をこえる不連続導通を生じないこと。	嵌合したコネクタに 11mm 秒間に 490m/s ² (50G) ののこぎり半波正弦波を生じるような衝撃を直交する三方向軸の正負方向に 3 回づつ合計 18 回与えること。 MIL-STD-202, 試験法 213, 条件 A
3.5.7	コネクタ挿入力	1.96N (200g) 以下 初期値：1 極当たり	3 回の挿入・引抜きを行なった後、毎分 100 mm の速度で 4 回目のコネクタアセンブリを挿入するのに要する力を測定し、1 極当りの値を計算して求める。 AMP 規格 109-5206

Fig. 2 (続く)

分類： 製 品 規 格	標準の名称： アンブモジュ 2 mm ピッチコネクタ (基板対基板取付型)	標準のコード： 108-5296	改訂 D	3 頁 7 頁中
----------------	---	---------------------	---------	-------------

項 目	試験項目	性 能 値	試 験 方 法						
3.5.8	コネクタ引抜き	0.098N(10g)以上 初期値：1 極当たり	3 回の挿入・引抜きを行なった後、毎分 100 mm の速度で 4 回目の嵌合した一組のコネクタを引抜くに必要な力を測定し、1 極当たりの値を計算して求める。 AMP 規格 109-5206						
3.5.9	コンタクト挿入力	Fig. 5(1)のゲージピン挿入力 2.94N(300g)以下 1 コンタクト当たり	毎分100mmの速度でFig. 5 に規定したゲージ(1)を使用して挿入力を測定する。 AMP 規格109-5206						
3.5.10	コンタクト引抜き	Fig. 5(2)のゲージピン引抜き力 0.098N(10g)以上 1 コンタクト当たり	毎分100mmの速度でFig. 5 に規定したゲージ(2)を使用して引抜き力を測定する。 AMP 規格109-5206						
3.5.11	耐久性(繰り返し挿抜)	物理的異常のないこと。 3.5.2, 3.5.9, 3.5.10 を満足すること。	毎時 500~600 回の速度で、下記の回数、挿入・引抜きを行う。						
			<table><tr><td>接触部 金めつき厚</td><td>挿入・引抜き 回数</td></tr><tr><td>0.76 μm 以上</td><td>100 回</td></tr><tr><td>0.2 μm 以上</td><td>50 回</td></tr></table>	接触部 金めつき厚	挿入・引抜き 回数	0.76 μm 以上	100 回	0.2 μm 以上	50 回
			接触部 金めつき厚	挿入・引抜き 回数					
0.76 μm 以上	100 回								
0.2 μm 以上	50 回								
3.5.12	はんだ付け性	試験面は新鮮なはんだ面が、95 % 以上であること。	はんだ付け部分をフラックス(アルファ 100, GX-5 又は GX-7)に 5~10 秒間浸漬した後、230±5℃のはんだ(すず 60%, 鉛 40%)槽中に 3±0.5 秒間浸漬して試験する。						
3.5.13	はんだ耐熱性 (本試験項目はリセプタクルコネクタのみ適用する。)	試験後物理的損傷を生じないこと。	プリント基板に装着した状態ではんだ付けタイン部を 260±5℃のはんだ槽中に 10±2 秒間浸漬して試験を行う。 MIL-STD-202, 試験法210, 条件 C						
3.5.14	熱衝撃	物理的異常のないこと。 3.5.2 を満足すること。	嵌合したコネクタを -40℃+ と 105℃ (各 30 分)の間の温度変化に 5 サイクルさらすこと。 MIL-STD-202, 試験法 107 条件 A						

Fig. 2 (続く)

分類： 製 品 規 格	標準の名称： アンプモジュ 2 mm ピッチコネクタ (基板対基板取付型)	標準のコード： 108-5296	改訂 D	4 頁 7 頁中
----------------	---	---------------------	---------	-------------

項 目	試験項目	性 能 値	試 験 方 法
3.5.15	温湿度サイクリング	物理的異常のないこと。 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 を満足すること。	嵌合したコネクタを、相対湿度95% で、25°C~65°C の温度変化に 10 サイ クルさらすこと。低周波振動と、 -10°C 寒冷衝撃は実施しない。 MIL-STD-202, 試験法 106
3.5.16	塩水噴霧	3.5.2 を満足すること。	嵌合したコネクタを5% の塩水噴霧に 48 時間さらすこと。 MIL-STD-202, 試験法101, 条件 B
3.5.17	亜硫酸ガス	3.5.2 を満足すること。	嵌合した状態で、下記の条件にて 24 時間暴露する。 亜硫酸ガス濃度: 10±3PPM 湿度: 90% 以上 温度: 室温 試験後の測定は室温中に 1 時間以上 放置した後に行う。

Fig. 2 (終り)

4. 試験順序

該当 項番	試験項目	試験グループ							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
		試験順序 (a)							
3.5.1	製品の確認検査	1, 9	1, 6	1, 9	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5
3.5.2	総合抵抗 (ローレベル)	2, 6		2, 8	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4
3.5.3	耐電圧	4, 8							
3.5.4	絶縁抵抗	3, 7							
3.5.5	振動				3				
3.5.6	物理的衝撃					3			
3.5.7	コネクタ挿入力			3, 6					
3.5.8	コネクタ引抜力			4, 7					
3.5.9	コンタクト挿入力		2						
3.5.10	コンタクト引抜力		3						
3.5.11	耐久性			5					
3.5.12	はんだ付け性		4						
3.5.13	はんだ耐熱性		5						
3.5.14	熱衝撃						3		
3.5.15	温湿度サイクリング	5							
3.5.16	塩水噴霧							3	
3.5.17	亜硫酸ガス								3

(a) 欄内の数字は試験を実施する順序を示す。

Fig. 3

5. 品質条件

5.1 試験環境

特に規定のある場合を除き性能試験は、下記の環境条件のもとで行うこと。

温度：15～35℃

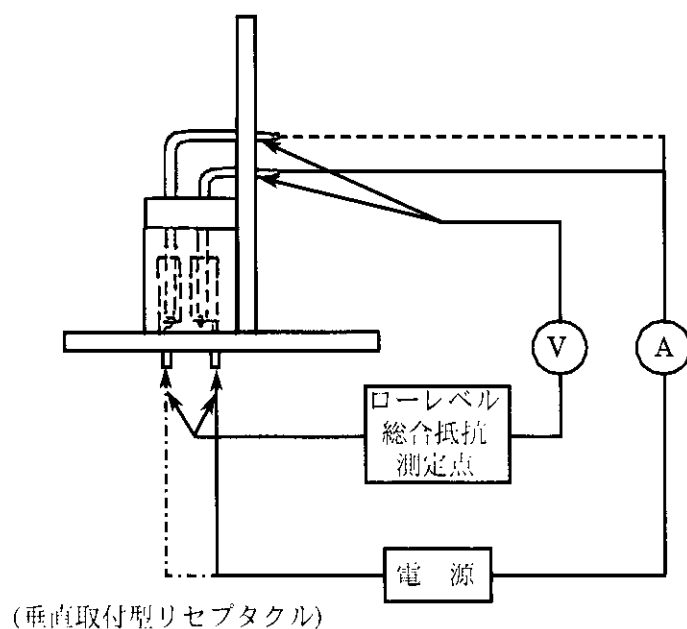
湿度：45～75%

気圧：650～800 mm Hg

5.2 試験試料

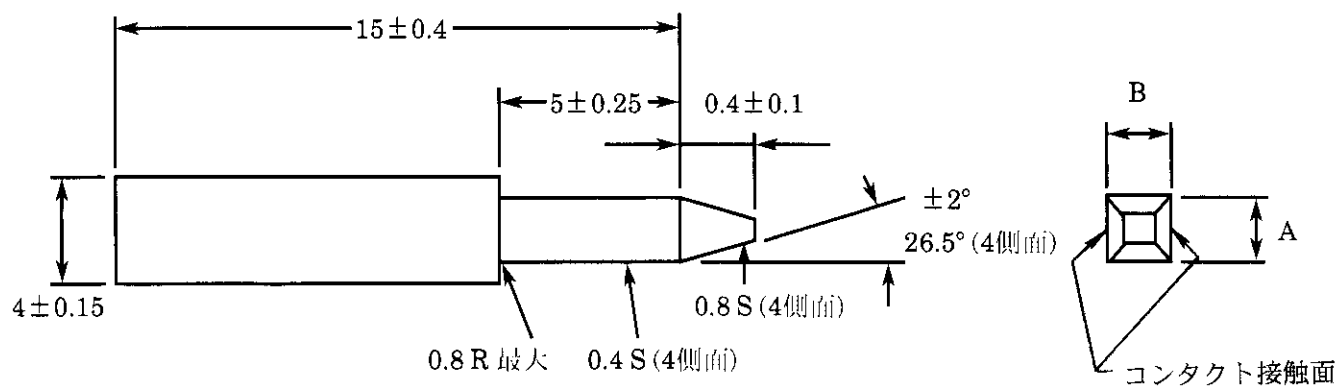
(1) 性能試験に用いる試料は、該当製品図面上の規定事項に合致したものであること。

(2) いずれの試料も特に規定しない限り、再度試験に用いてはならない。



注: 試験を実施する際、ポストのめっき仕様は、リセプタクルのめっき仕様と同じ仕様のものを使用すること。

Fig.4 ローレベル総合抵抗測定点



ゲージ	A	B
(1)	0.5 ± 0.005	0.56 ⁺⁰ _{-0.003}
(2)	0.5 ± 0.005	0.44 ^{+0.003} ₋₀

注: 1. 材 料: 工具鋼・熱処理: ロックウェル C 50-55

2. 測定時: ゲージ表面の潤滑剤はきれいに除去すること。

Fig.5 挿入及び引抜ゲージ

分類: 製 品 規 格	標準の名称: アンプモジュ 2 mm ピッチコネクター (基板対基板取付型)	標準のコード: 108-5296	改訂 D	7 頁 7 頁中
----------------	--	----------------------------	---------	-------------